株式会社タムラ製作所

2014年3月期 決算概要

2014年5月15日

TAMURA

Your One and Only Company

内容

1. 2014年3月期 決算概要

2. 2015年3月期 通期業績予想

1. 2014年3月期 決算概要

損益計算書(要約)

- 緩やかな景気回復のもと、戦略事業の伸長により売上高・営業利益が伸長
- 為替差益の計上もあり、経常利益・税引前利益・当期純利益は大幅に増加

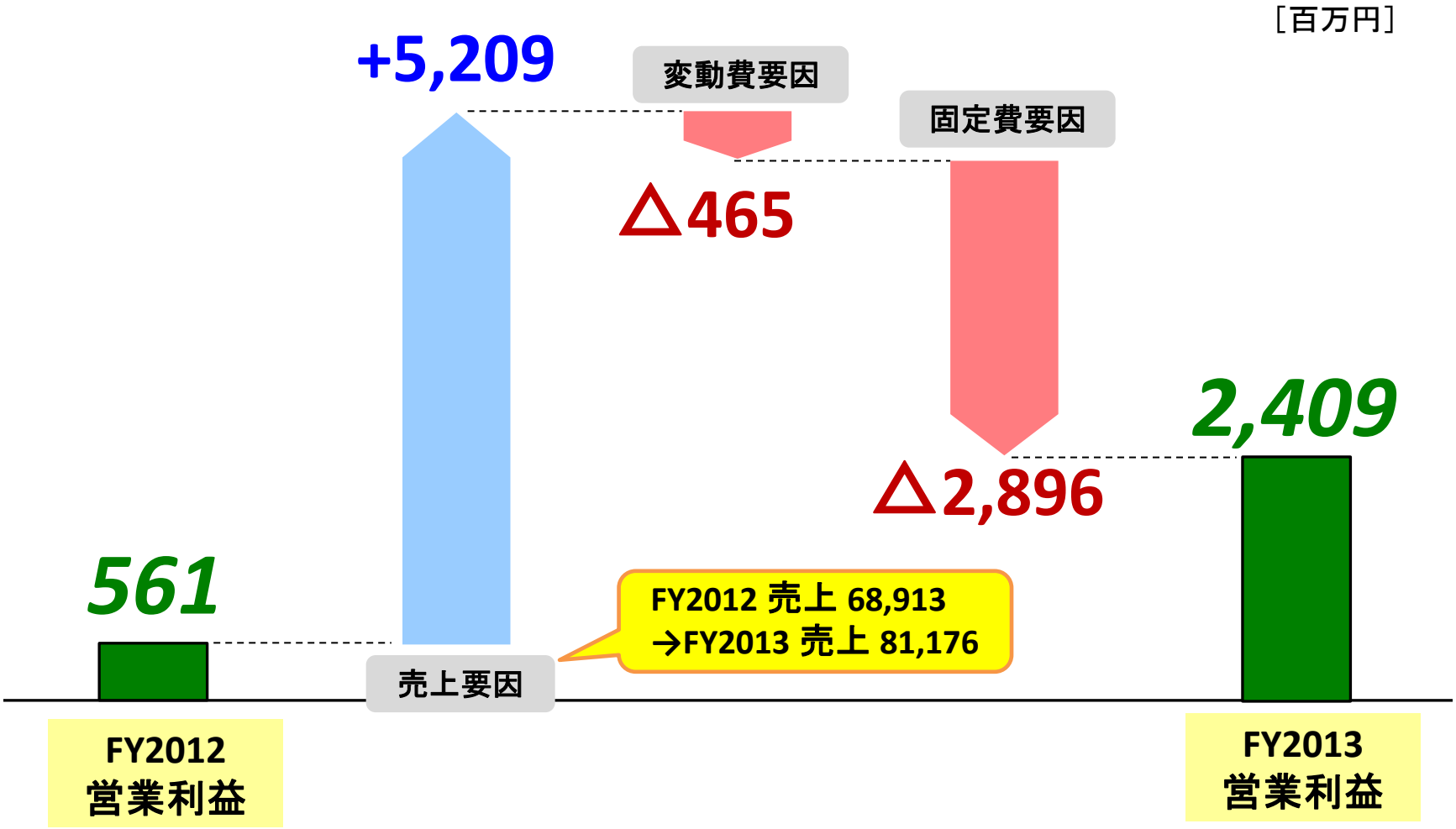
［百万円］

	FY2012	**FY2013**	前年同期 増減額	前年同期 増減率
売上高	68,913	**81,176**	12,263	118%
営業利益	561	**2,409**	1,847	429%
営業外損益	△91	**482**	573	―
経常利益	470	**2,891**	2,421	615%
特別損益	△694	**△150**	543	―
税引前損益	△223	**2,740**	2,964	―
当期純損益	△767	**1,797**	2,564	―

14/03	期中平均実績為替レート	$1= 99円 17銭
14/03	期中平均社内為替レート	$1= 99円 49銭
14/03	期末日実績為替レート	$1= 102円 92銭
参考)	計画為替レート(上期)	$1= 94円
	計画為替レート(下期)	$1= 100円

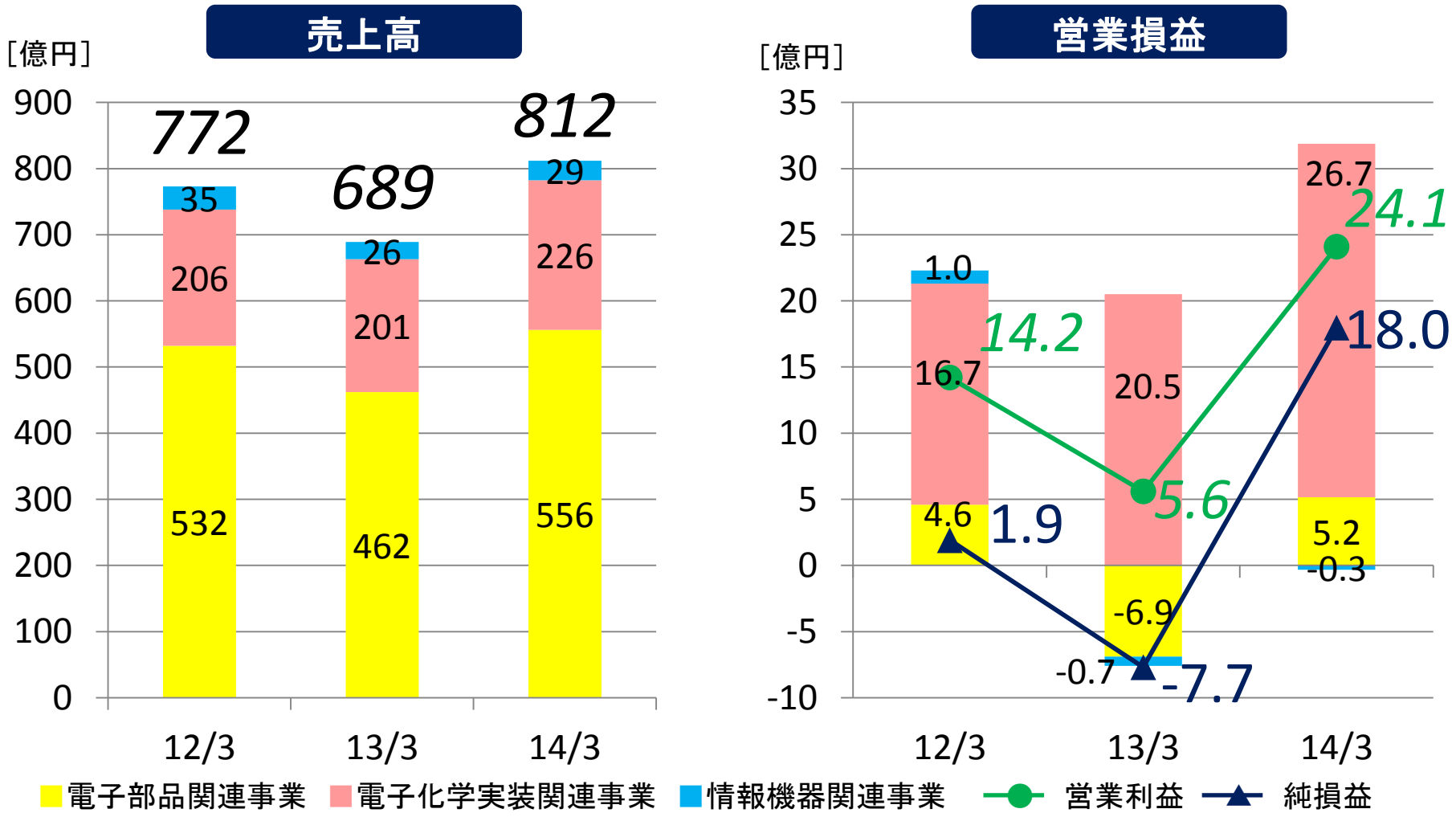
損益の増減分析

- 事業活動の活発化に加え、為替の影響により、前年比較で売上高や経費が増加
- 円安は原材料や海外生産品の輸入においてマイナス要因となったが、営業面・生産面からの企業努力により、影響を最小限に抑えた



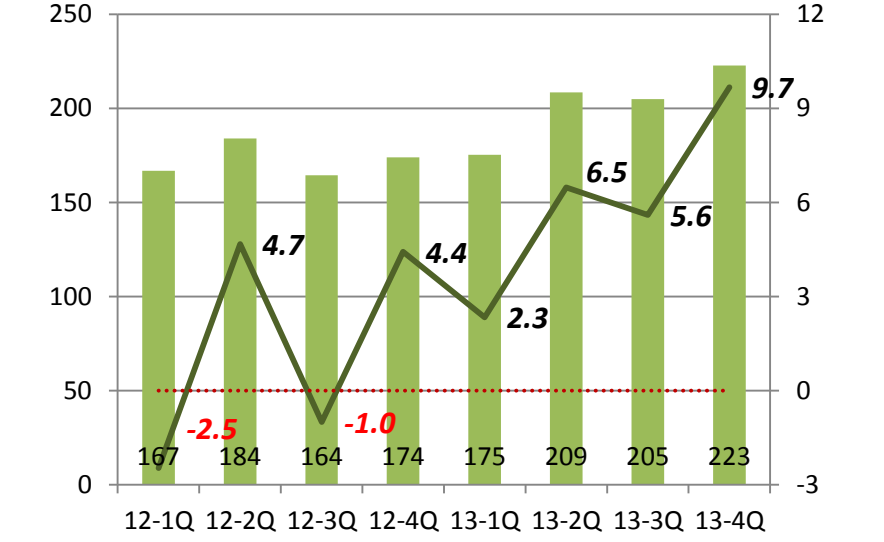
事業部門別の売上高・損益推移

- 電子部品： 好調な市場のニーズの取り込みと構造改革効果で、大幅に収益改善
- 電子化学実装： 戦略市場向け製品の伸長で、利益拡大
- 情報機器： 市場環境は厳しいが、新製品の採用もはじまり、損失縮小

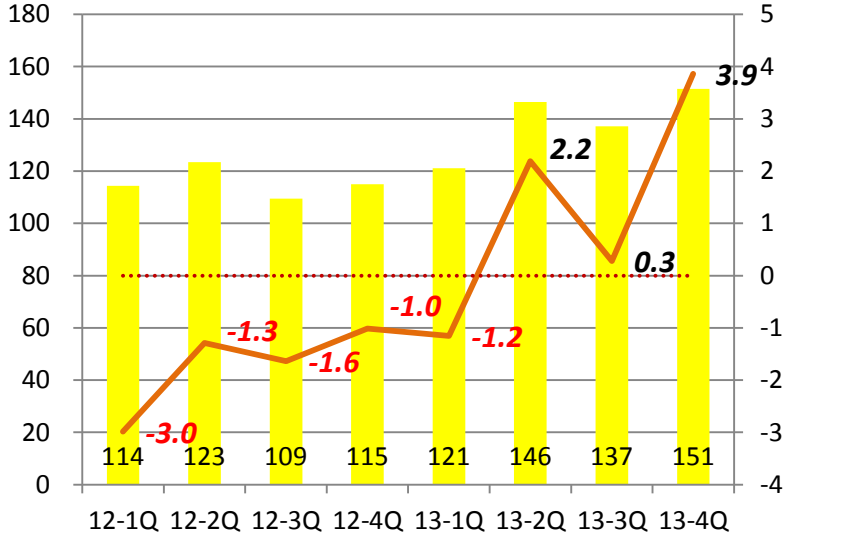


事業部門別の売上高・損益（四半期推移）

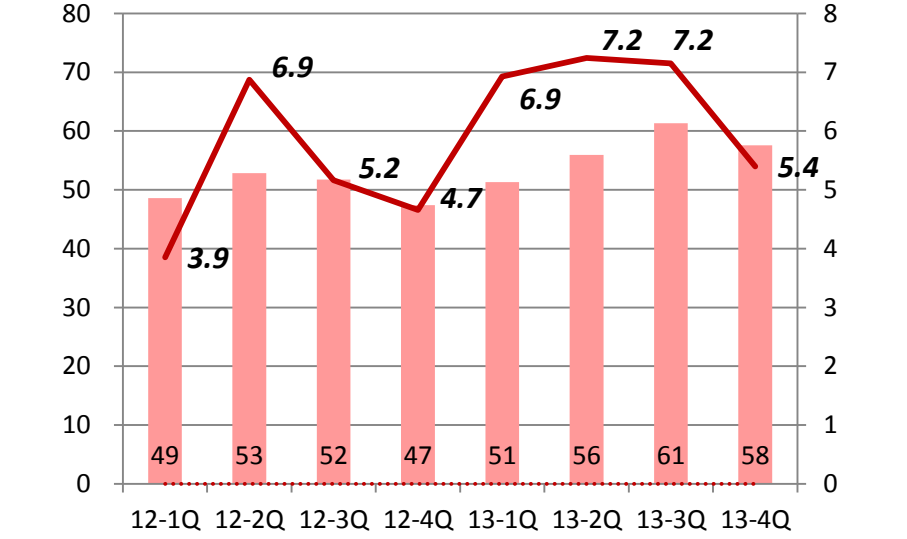
グループ連結



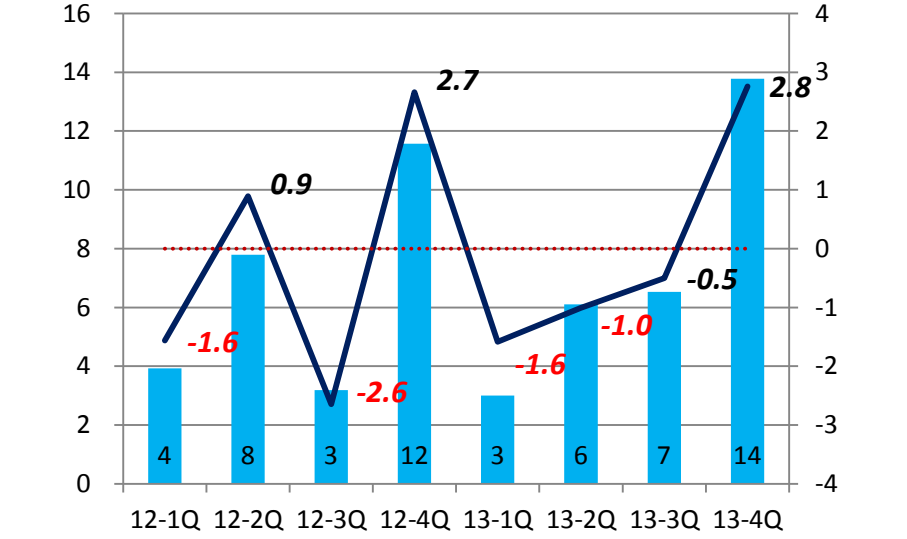
電子部品関連



電子化学実装関連



情報機器関連



電子部品事業の収益改善施策

2013年3月

人員削減を伴う構造改革

2013年度

財務の視点 ― 顧客の視点 ― 業務プロセスの視点 ― 人材の視点

コスト管理強化

好調な市場のニーズの取り込み

グローバル最適配置

グローバル人材強化

円安の影響

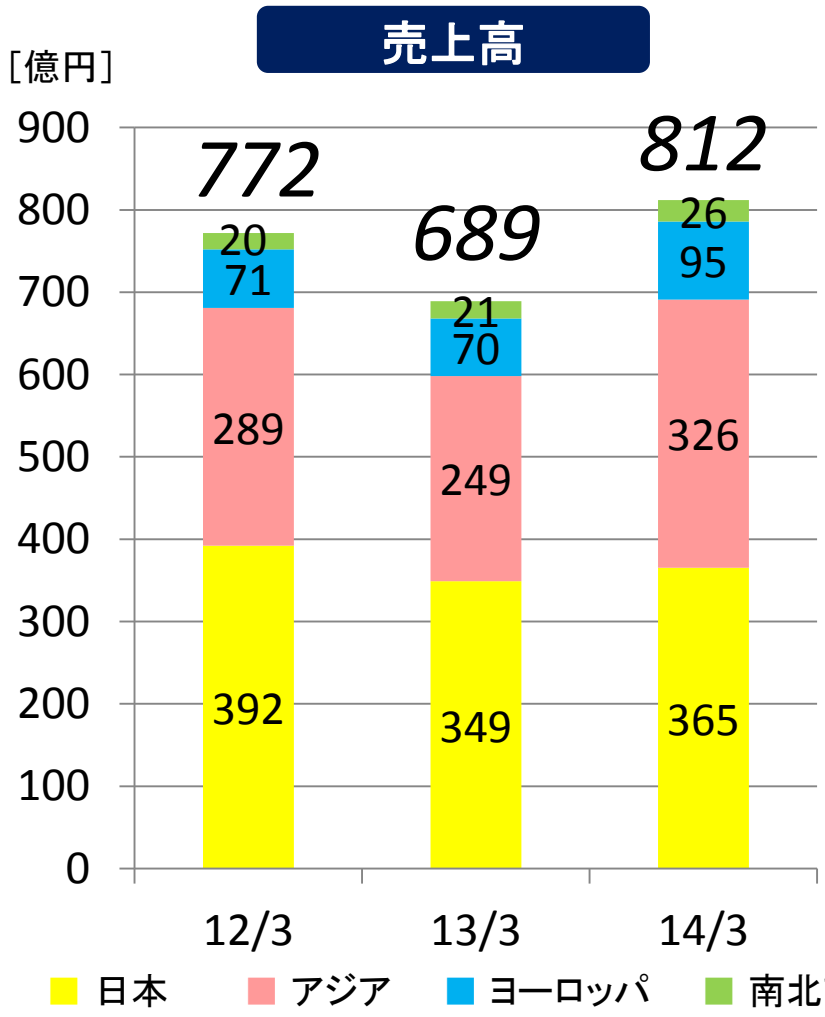
OUT −OUT	OUT −IN	IN −OUT
利益の円換算でプラス	原価高でマイナス	取引少影響無
	対策実施	○

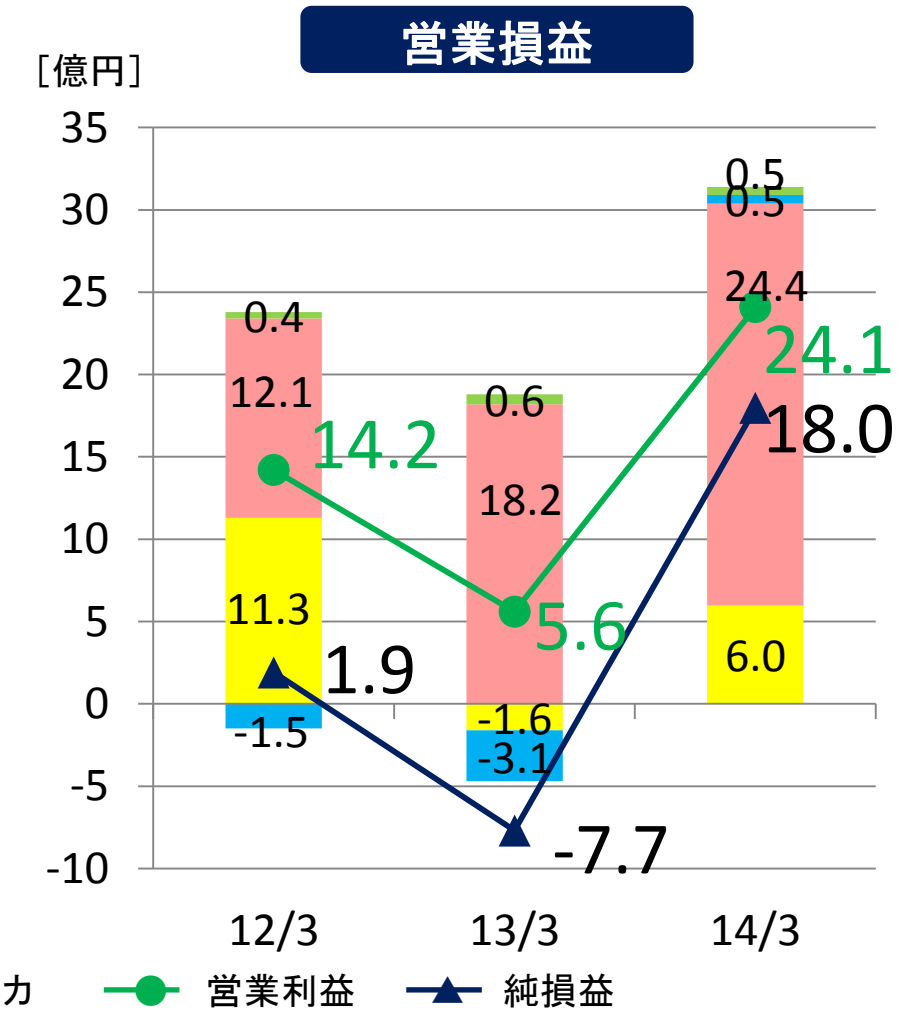
- 為替変動価格（ローリング化）
- 地場調達の強化
- 経営コックピットによる採算管理強化
- 不採算品目撲滅
- 高付加価値品目拡大
- No.1商品・オンリーワン商品を好調市場へ投入
- エアコン・電動工具
- エネルギー
- 産業機械
- 海外に関する業務は現地完結型に移行 コストの高い日本は付加価値の高い業務に集中
- イギリス→チェコ
- 中国→バングラデシュ
- ミャンマー拠点活用
- 業務・設計の標準化
- ナショナルスタッフの育成・登用

2014年度

地域別の売上高･損益推移

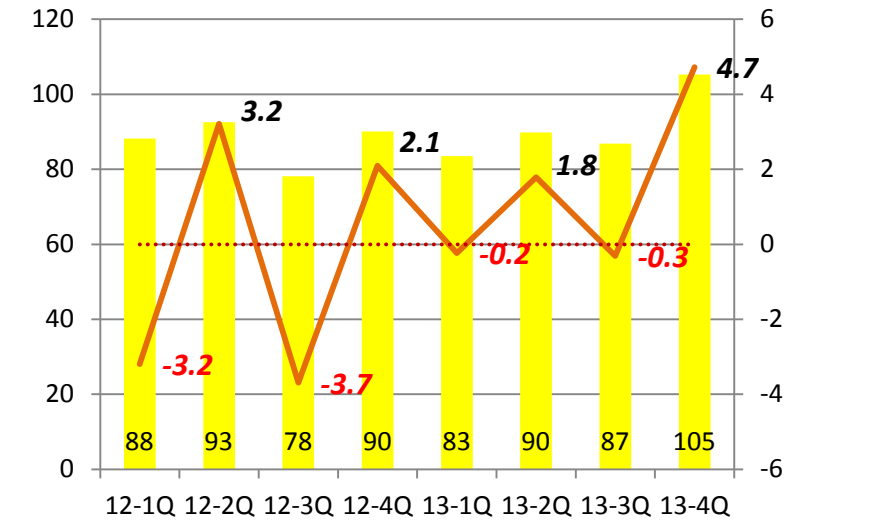
- 日本: 回復傾向の市場環境のもと、伸長市場に高付加価値製品を投入し、黒字転換
- アジア: 中国市場を中心に堅調に推移
- 欧米: エネルギー市場を中心に、非日系顧客への販売も広がり、収益改善



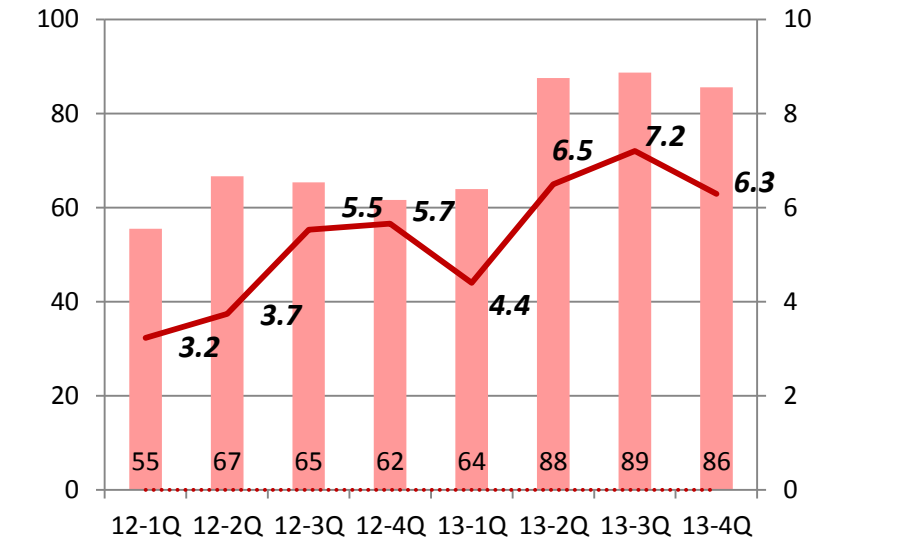


地域別の売上高・損益（四半期推移）

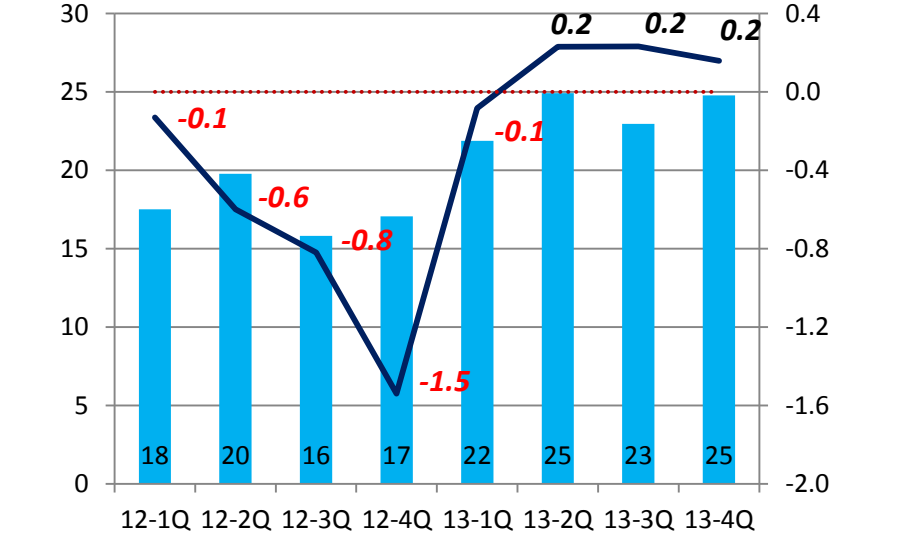
日本



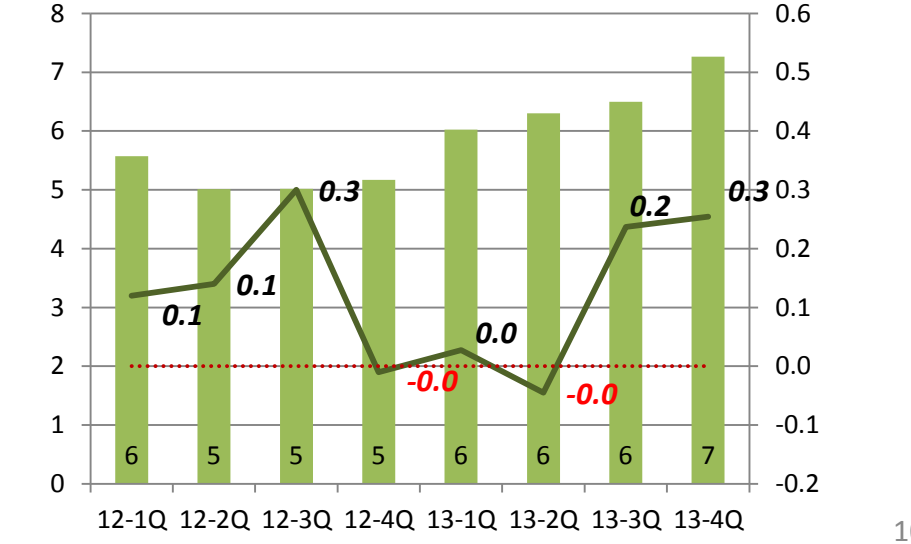
アジア



ヨーロッパ



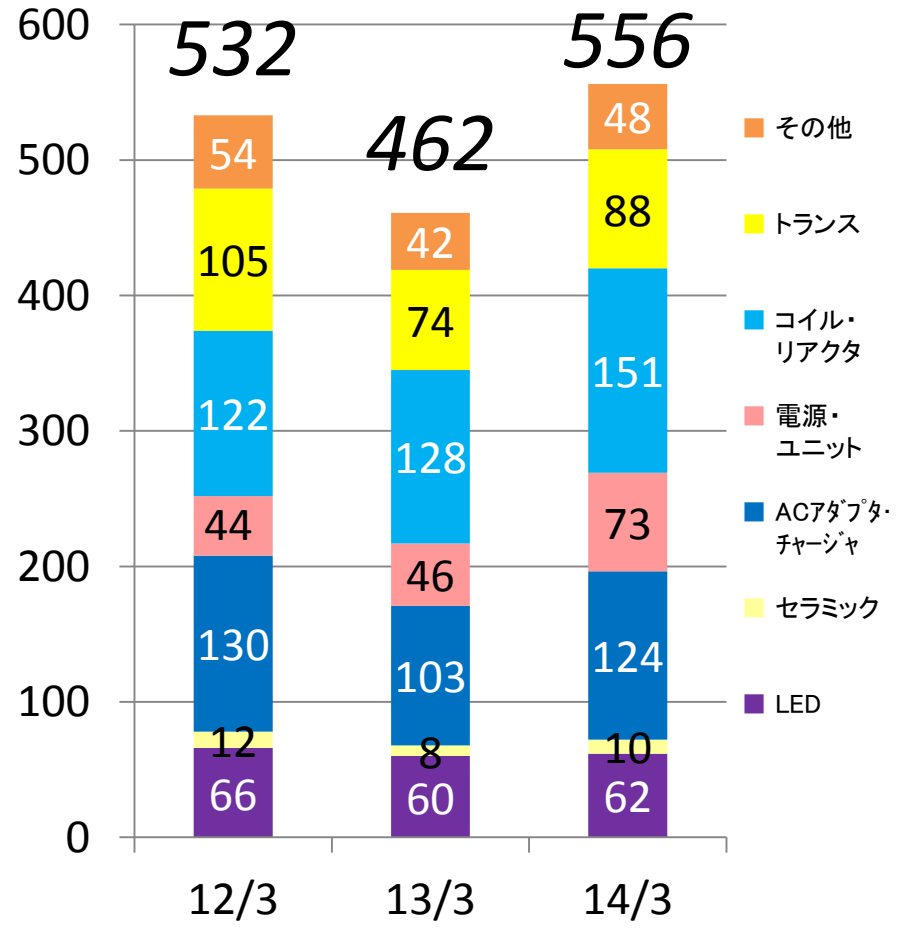
アメリカ



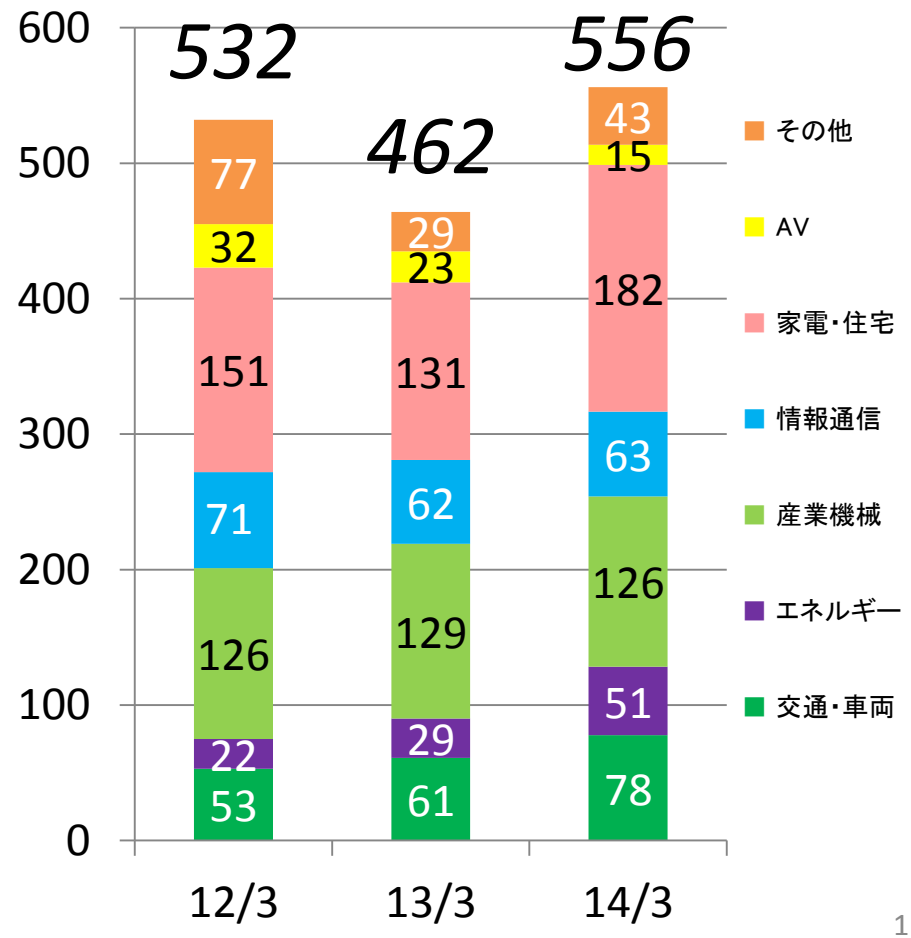
電子部品関連事業の売上高推移

- 回復基調にある国内外のニーズを取り込んで、エアコンや電動工具関連、太陽光パワコンや屋外用LED電源などのエネルギー関連が堅調に推移
- 製品別では、エアコン・エネルギー・車載などの各分野でキーとなるリアクタが堅調

製品別 売上高

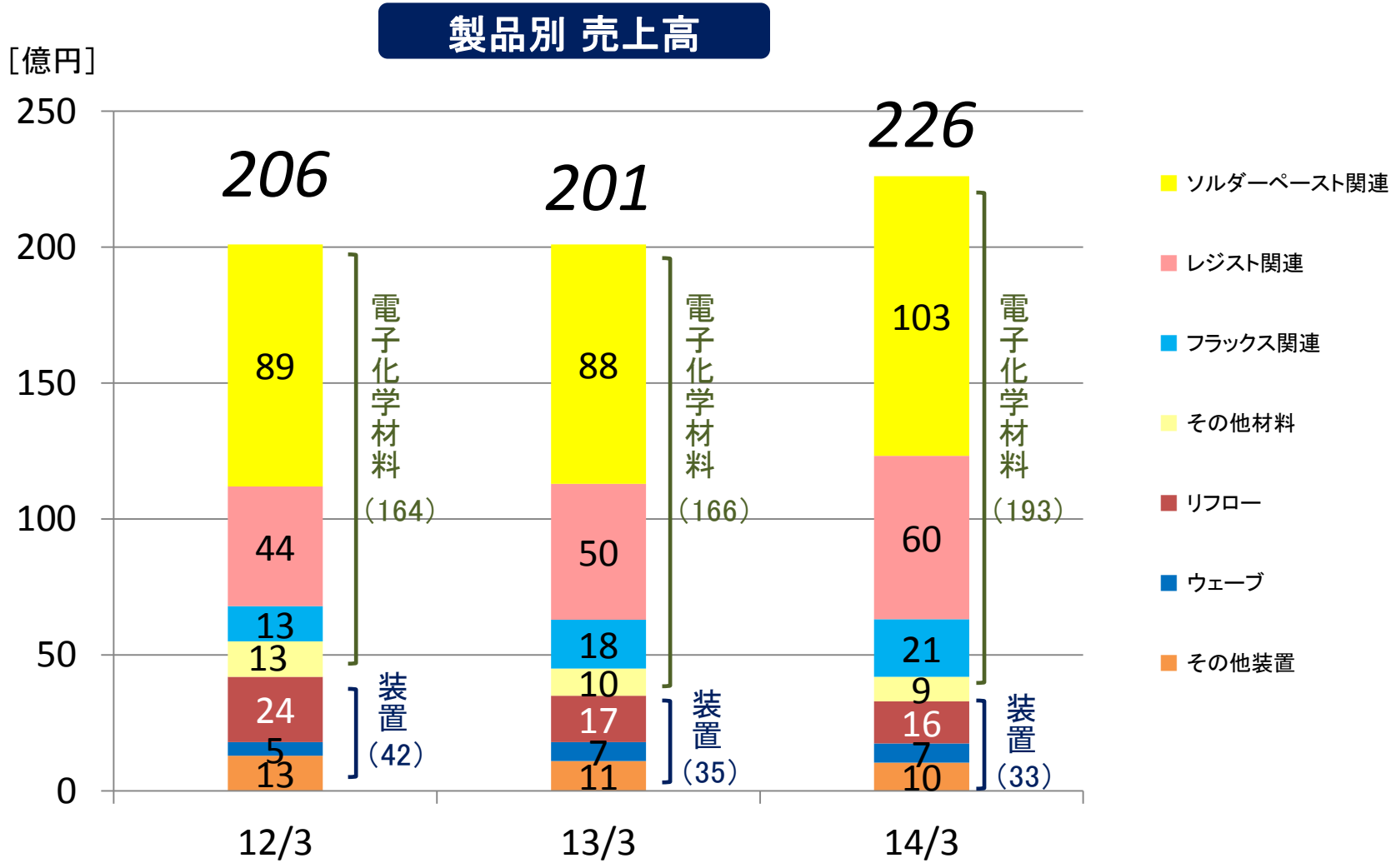


市場別 売上高



電子化学実装関連事業の売上高推移

- 電子化学事業は、車載用材料や、スマートフォン向けフレキシブル基板用ソルダーレジストなどが、市場のニーズに応えて伸長
- 実装装置事業は厳しい市場環境が続くが、保守サービス活動の強化などでカバー



貸借対照表（要約）

■ 総資産は 81.1億円増加（棚卸資産 20.0億円、有形固定資産 24.3億円）

■ 有利子負債は 22.3億円増加。純資産は純利益と為替換算調整勘定により 37.6億円増加。

［百万円］

	13/3	14/3	対期末増減	
流動資産	43,775	**49,986**	6,211	
（現預金）	10,104	**12,245**	2,140	
（売上債権）	20,096	**21,644**	1,548	
（棚卸資産）	11,322	**13,324**	2,002	※1
（その他流動資産）	2,251	**2,771**	520	
固定資産	22,882	**24,781**	1,898	
（有形固定資産）	17,356	**19,782**	2,426	※2
（無形固定資産）	1,475	**1,470**	△5	
（投資、その他）	4,050	**3,528**	△522	
資産合計	66,658	**74,767**	8,109	
流動負債	29,690	**24,736**	△4,953	
（仕入債務）	10,669	**12,286**	1,617	
固定負債	8,832	**18,136**	9,303	
［有利子負債］	20,758	**22,983**	2,225	※3
負債計	38,522	**42,872**	4,350	
純資産合計	28,135	**31,895**	3,759	※4
負債・純資産合計	66,658	**74,767**	8,109	

■ **主な増減**

※1 棚卸資産　+2,002

※2 有形固定資産　+2,426

うち児玉新工場　+1,820

※3 有利子負債　+2,225

うち流動　△6,295
うち固定　+8,520

※4 純資産　+3,759

うち当期純利益　+1,797
為替換算調整勘定　+3,078
退職給付に係る調整累計額　△1,138

キャッシュフロー（要約）

- 営業CF：税前利益（27.4億円）相当のCF確保
- 投資CF：児玉新工場（電子化学）建設 18.2億円により支出増加
- 財務CF：長期借入金の借入 20.6億円

［百万円］

	13/3	**14/3**	前年同期増減額
営業活動によるキャッシュフロー	3,630	**2,940**	△689
投資活動によるキャッシュフロー	△1,715	**△3,475**	△1,760
フリーキャッシュフロー	1,915	**△534**	△2,449
財務活動によるキャッシュフロー	△1,959	**1,335**	3,295
キャッシュの増減	289	**1,943**	1,653
キャッシュの残高	9,943	**11,973**	2,030

2. 2015年3月期 通期業績予想

損益予想

■ 収益性の向上を目標の第一に掲げ、最適なグローバル体制、健全な経営体質を構築すると共に、当社のオンリーワン技術を駆使した競争力ある製品をタイミングよく市場投入し、目標達成を目指します。

［百万円］

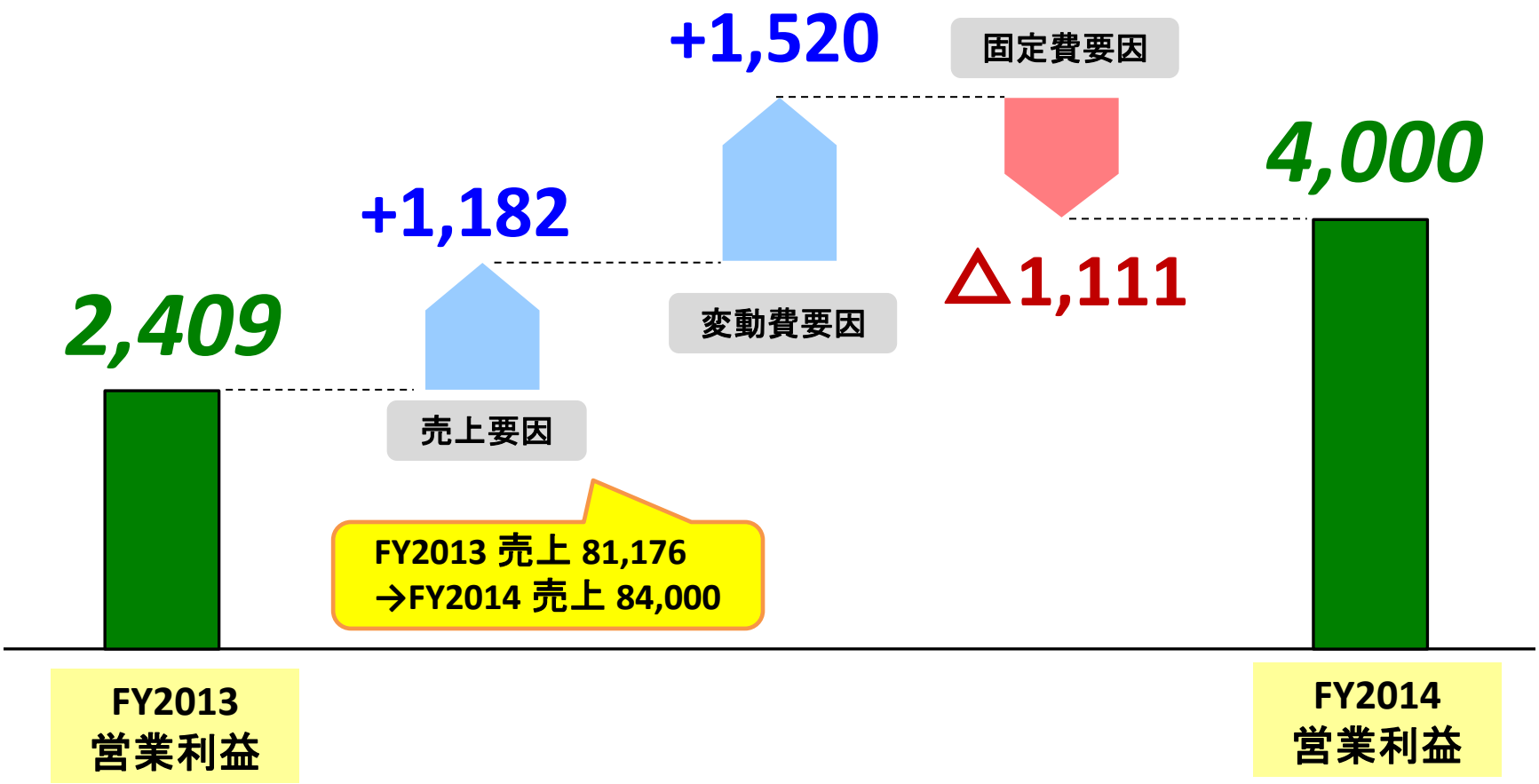
	FY2013 通期 実績	**FY2014 通期 予想**	対前年 増減額	対前年 増減率
売上高	81,176	**84,000**	2,824	103%
営業利益	2,409	**4,000**	1,591	166%
経常利益	2,891	**3,700**	809	128%
当期純利益	1,797	**2,700**	903	150%

15/03　計画為替レート　　$1= 105円

損益の増減分析

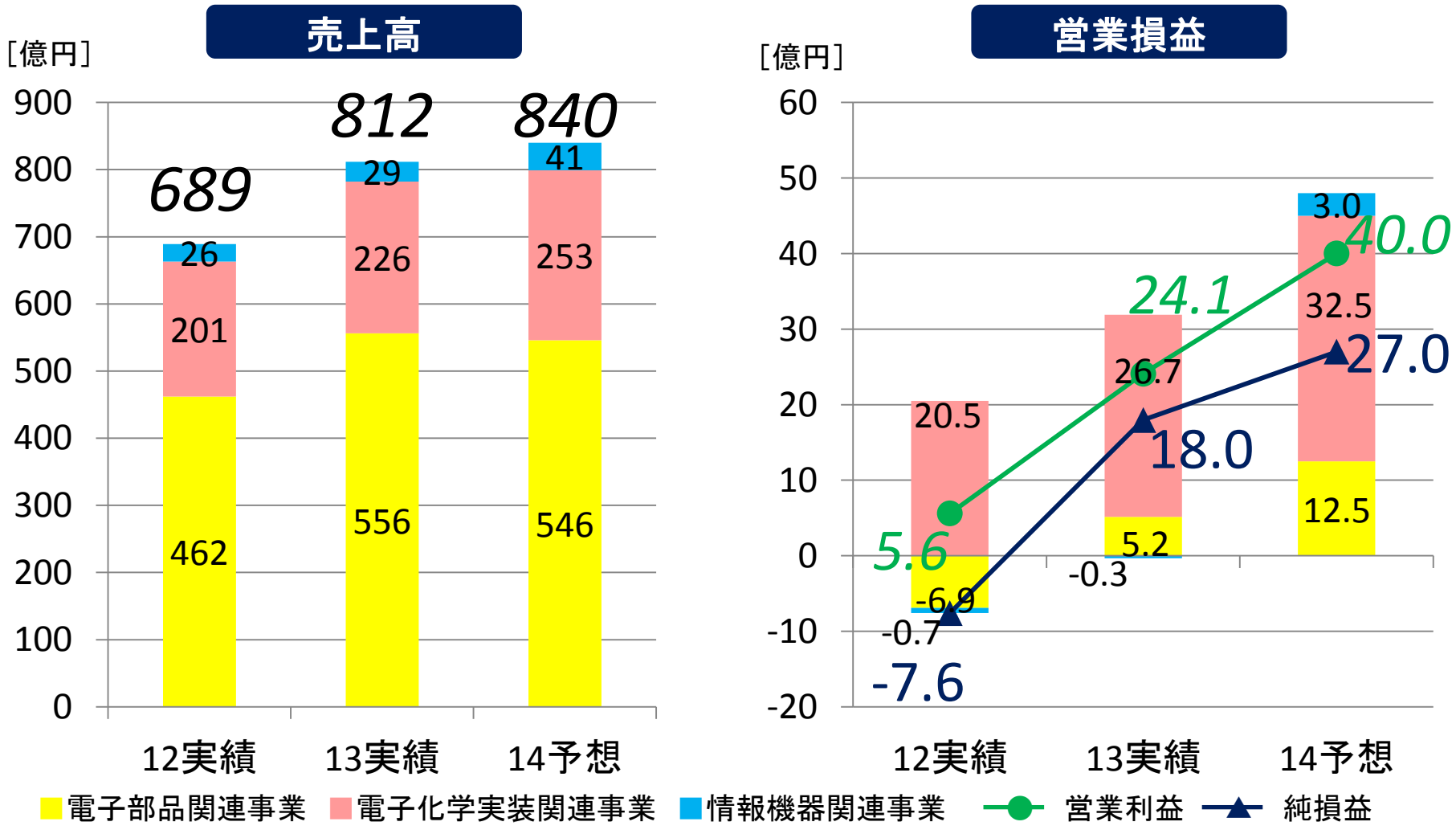
- 高付加価値なオンリーワン・ナンバーワン製品の拡大により、変動費率を抑え収益性を拡大
- 最適なグローバル体制の構築により、固定費増加は最小化を図る

［百万円］

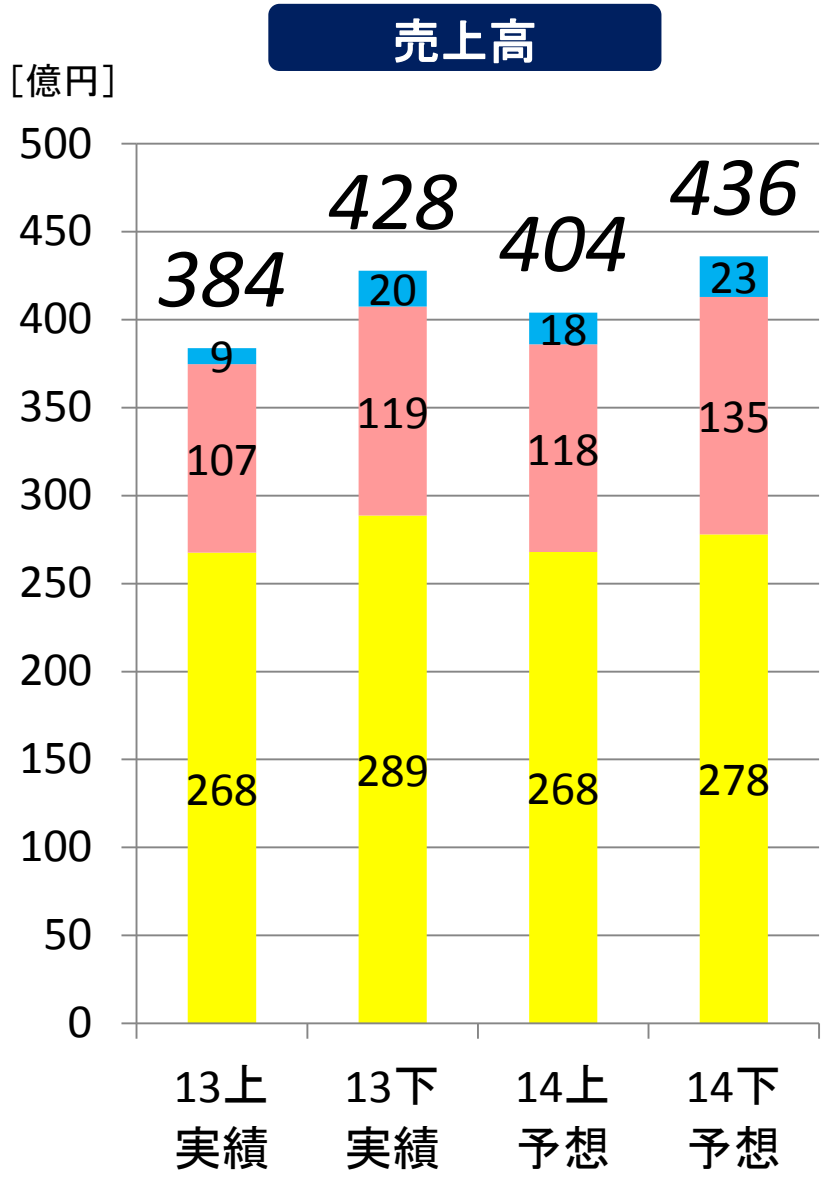


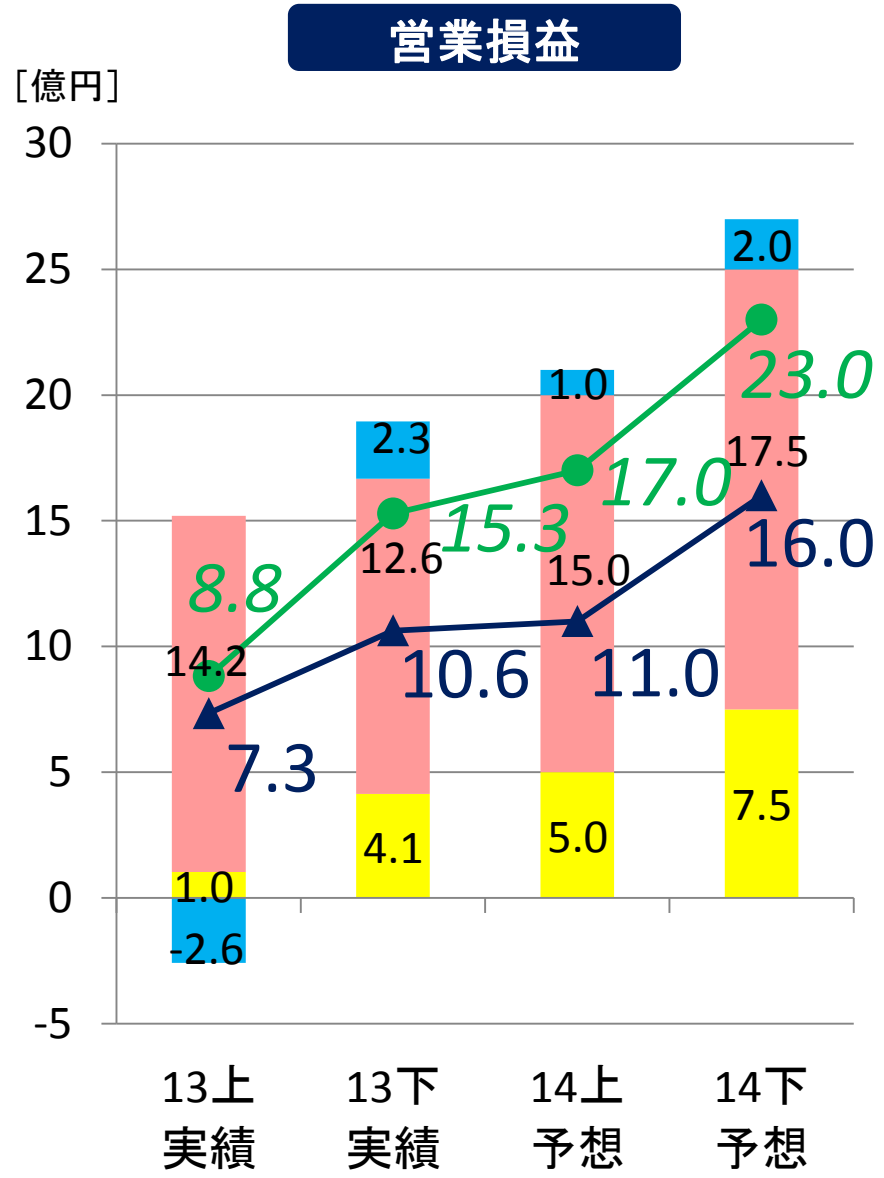
事業部門別の売上高・損益見通し（年次）

- 電子部品：収益性の拡大を第一に、オンリーワン・ナンバーワン製品に集中
- 電子化学実装：　戦略市場向けの新製品を拡販し、売上・利益を更に拡大
- 情報機器：　ワイヤレス向けなどターゲット市場のニーズを捉えて黒字化を図る



事業部門別の売上高・損益見通し（半期）

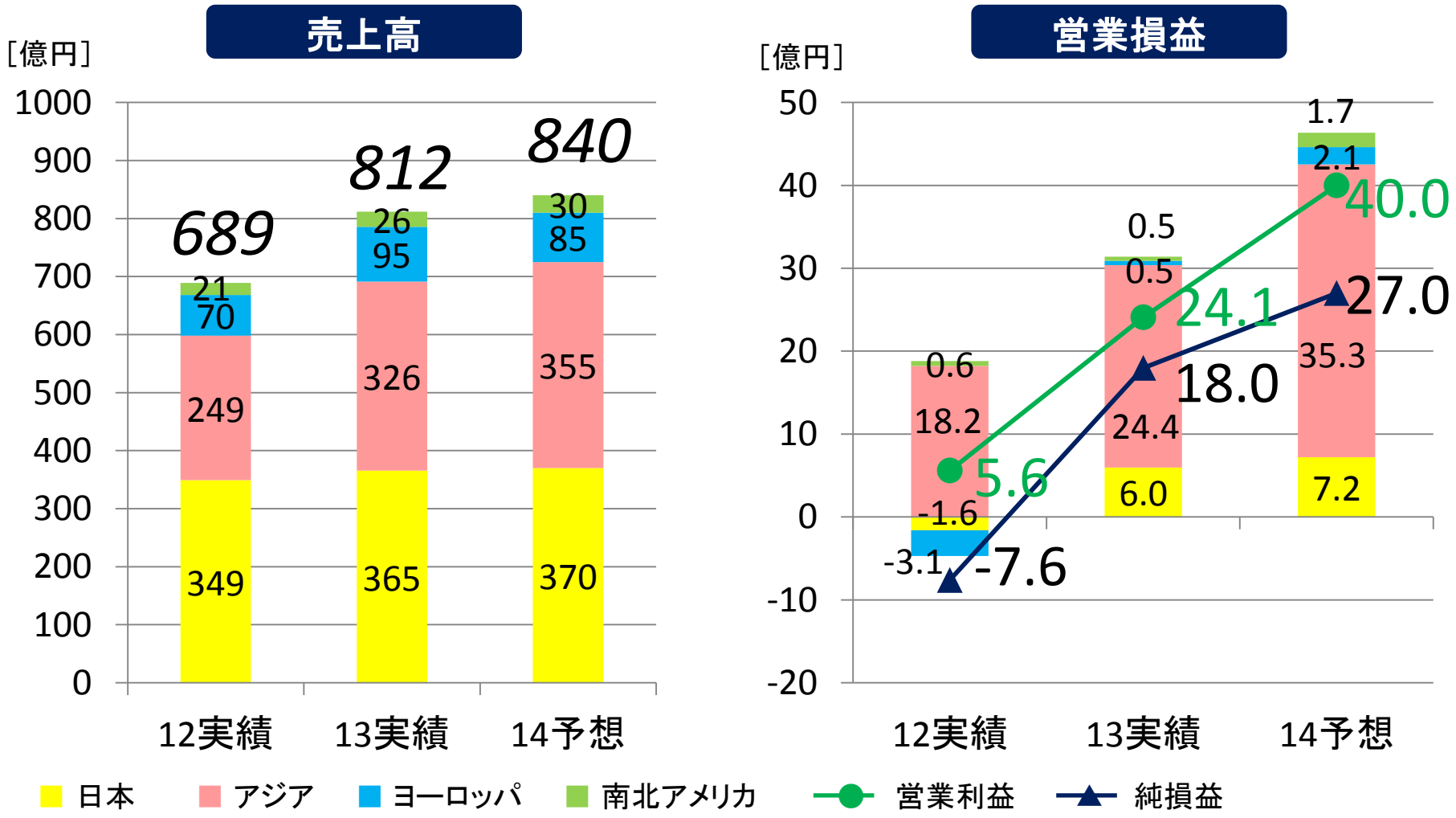




電子部品関連事業　電子化学実装関連事業　情報機器関連事業　営業利益　純損益

地域別の売上高・損益見通し

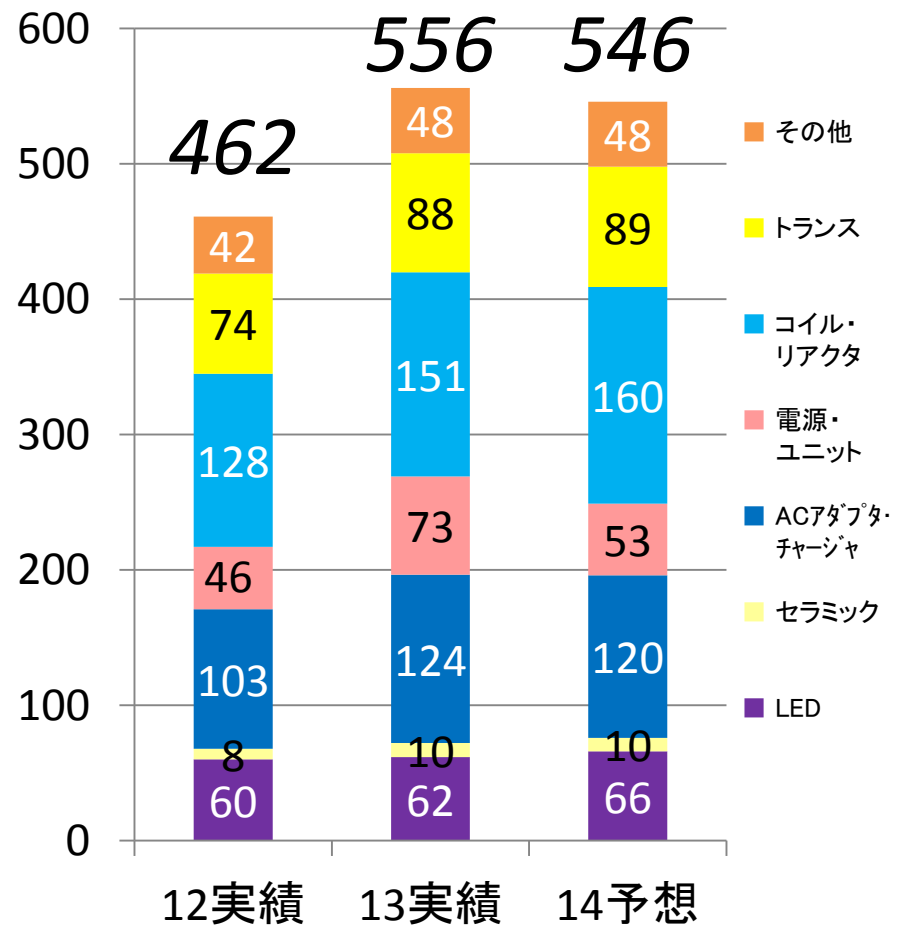
- 日本：ターゲット市場に向けた取り組みに集中し、着実に収益を確保
- アジア：　固定費最適配置の取り組みを加速し、引き続き収益を牽引
- 欧米：　非日系顧客への販売を拡大し、利益体質へ



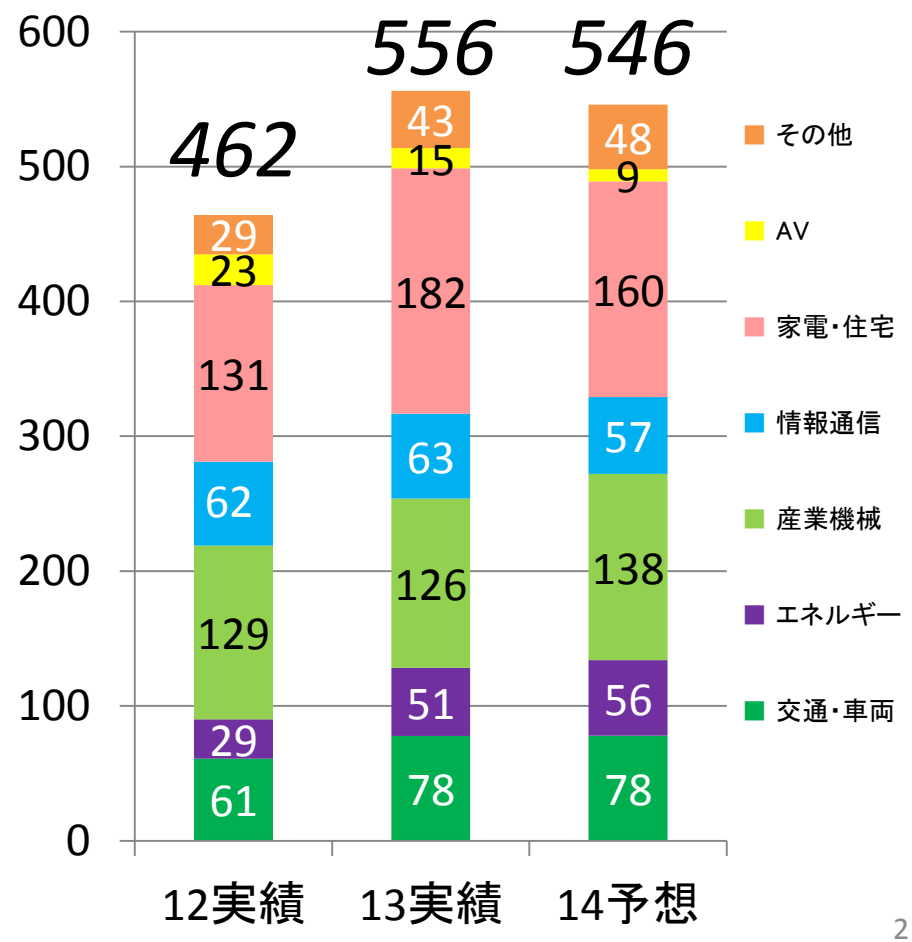
電子部品関連事業の見通し

- 引き続きグローバルにニーズの高まる家電住宅・エネルギー、回復基調の産業機械関連などターゲット市場に集中。製品では、これらのキーになるリアクタが伸長。
- 一部EMS客先の材料が無償支給に変更になったため売上高はやや減少

製品別 売上高

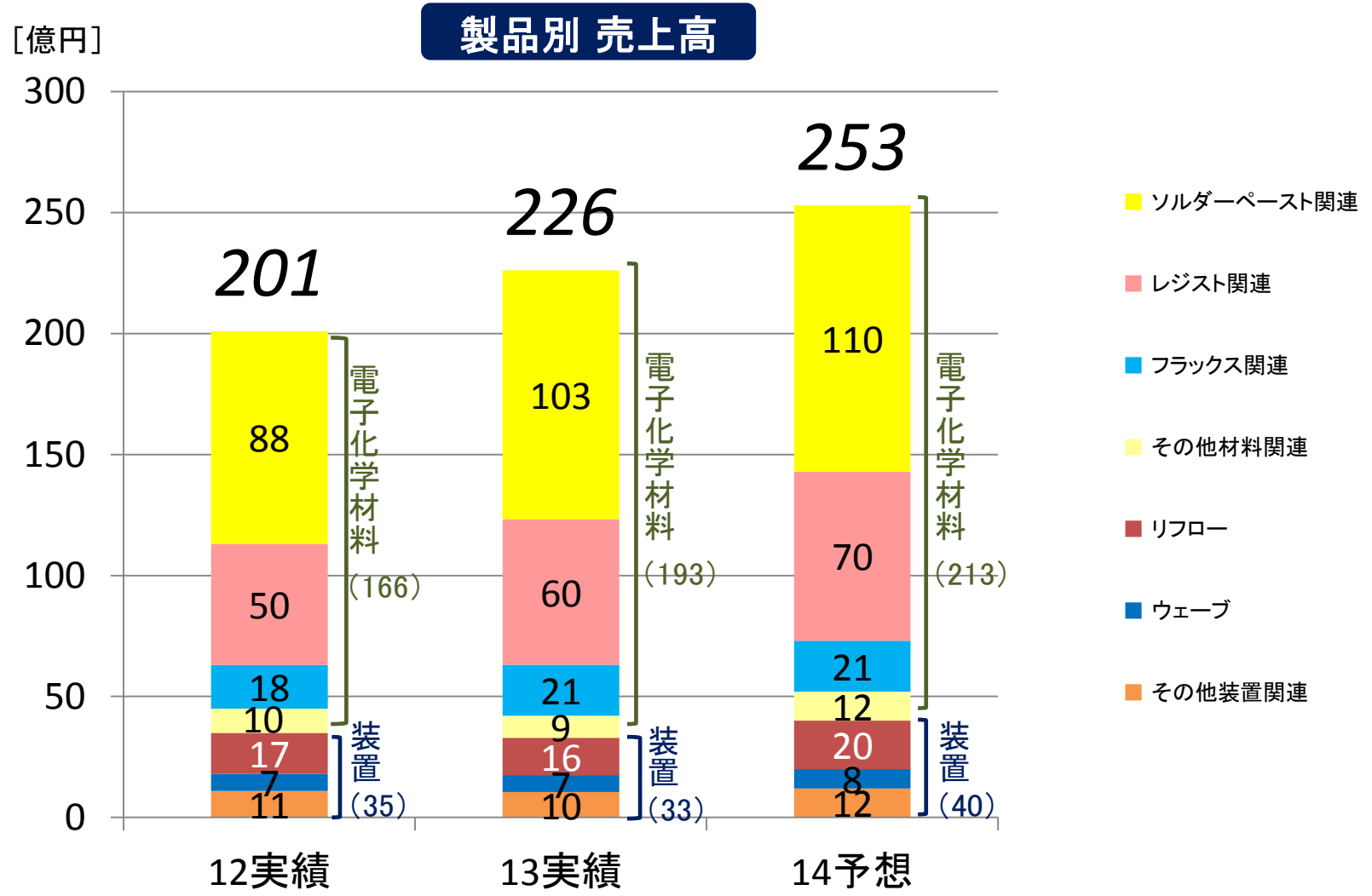


市場別 売上高



電子化学実装関連事業の見通し

- 電子化学事業は、車載市場、スマートフォン・タブレットPC市場、エネルギー市場（太陽光）の3分野をターゲットに、新規顧客開拓、新製品開発を更に加速
- 実装装置事業は、設備投資に回復の兆しがあり、着実な回復を目指す



製品トピックス①

電子化学実装関連

独自開発の酸化防止技術により0201などの微細チップ部品実装に最適な ハロゲンフリー＊1、鉛フリーのソルダーペーストを開発
スマートフォンや今後、開発が加速すると考えられるウェアラブル製品向けの微細部品への採用を見込み国内外で広くサンプル出荷をスタート

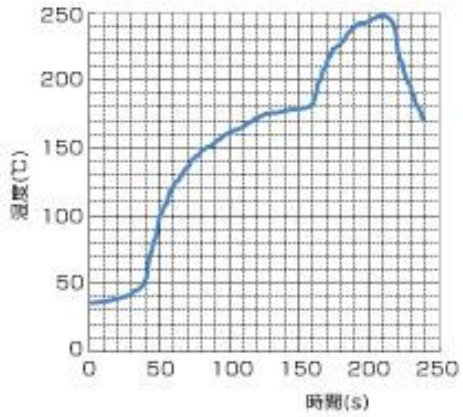
概要

ソルダーペースト「TLF-204G-HFシリーズ」

- ハロゲンフリーであっても、ハロゲン入りタイプと同等のBGAの未融合・微細パッドの 溶融性を可能＊2とした、はんだ粒径TYPE６（5～15 μm）のソルダーペーストを開発。
- 独自開発・特許取得（特許第4447798号）の酸化防止技術によるフラックスを使用。

＊１：国際電気標準会議（IEC）61249-2-21、米国電子回路工業協会（IPC）4101B 規格に準拠。
＊２：酸素濃度1000ppm以下の窒素雰囲気下にてリフロー（添付プロファイル）

画像：
TLF-204G-HFシリーズ　０２０１C実装例
ご提供部品：株式会社村田製作所　様



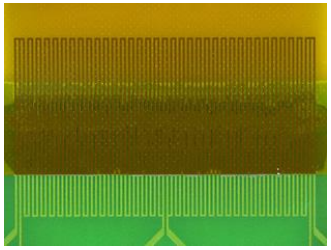
評価リフロープロファイル

製品トピックス②

電子化学実装関連

導電性接合材 SAMシリーズ

■ SAM32-401-11

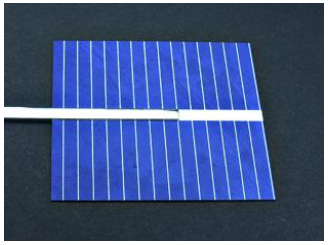


SnBi系　異方導電接続　コネクター接続代替

150℃・6秒でリジッド基板とフレキシブル基板を熱圧着

- 低荷重での接続が可能です（1.0MPa）
- 狭ピッチでの接続が可能です。
- デッドスペースの縮小が可能です。
- Auランドのみでなく、Cu-OSPランドでの接続が可能です。
- 150℃でリワークできます 。
- 鉛フリー、ハロゲンフリー、VOCフリーな材料です。

■ SAM20-401-11

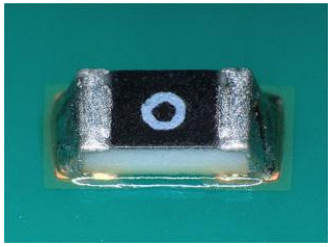


SnBi系　太陽電池用途

一般タブ接続方式のバスバー電極とタブ線の接続に最適

- 低温（160℃／4分）での合金接合と樹脂硬化が可能です。
- 鉛フリー合金を使用しています。
- ハロゲンフリーでVOCフリーの製品です。
- 連続印刷時の粘度経時変化が少ない。
- 金属接合と樹脂接着を同時に行うことにより、高い接合信頼性を可能にしました。

■ SAM10-401-27



SnBi系　導電性接合材（低温接合タイプ）

チップやカメラのモジュールの実装に

- 低温大気リフロー（160℃／4分）での合金接合と樹脂硬化が可能です。
- Pbフリー合金を使用しています。
- 0603チップ実装に対応可能です。
- ハロゲンフリーでVOCフリーの製品です。
- 無洗浄でありながら、高い信頼性をもっています。
- 連続印刷時の粘度経時変化が少ない。

製品トピックス③

電子化学実装関連

京セラ株式会社様の世界最軽量※1防水スマートフォン「DIGNO® R」に対抗電極間の導電性と隣接電極間の絶縁性を可能にした導電性接合材「SAM32」を供給

京セラ株式会社（以下京セラ）様が開発・製造した世界最軽量※１の防水スマートフォン「DIGNO® R SoftBank 202K」（2013年7 月5 日、ソフトバンクモバイル様より発売）に、当社の導電性接合材料「SAM32」を供給していますので、お知らせいたします。
導電性接合材「SAM32」は、リジット基板とフレキシブル基板の接合やフレキシブル基板間の接合において、対抗電極間の導電性と、隣接電極間の絶縁性を同時に保持できる接合材です。
低圧力、低温、短時間での接合により、SAM32 を接合した基板背面に実装された部品へのストレスを減らし、今まで実装できなかった部品実装した基板背面部分へのフレキシブル基板の接合が可能となった点が高く評価され、「DIGNO® R」の接合部分に採用いただいています。

概要

導電性接合材「SAM32」は、ディスペンサー供給のため塗布自由度が高く、低圧力による接合のためデッドスペースが少なくなる設計の自由度があります。

京セラ様「DIGNO® R」における当社「SAM32」のご採用例

１．リジッド基板へのフレキ基板接合
　　SAM32 使用による接合を採用したことで接合部の基板背面への部品実装を実現。

２．フレキ基板間接合
　　フレキ基板間の接合において、コネクターレス接合を実現。

これらの結果、基板面積を２０％削減。「DIGNO® R」の軽量化への貢献をすることができました。

SAM32の特徴

- 低温・短時間接合 150℃（6 秒）
- 低荷重接合 1 MPa
- Ａｕランド、Ｃｕ-0SP ランド、ともに接合可能。
- 150℃でリワークが可能。
- ディスペンサーによる塗布。

注）・当社製品SAM32 はパナソニックファクトリーソリューションズ社のライセンスに基づく製品です。
・「DIGNO」は京セラ株式会社様の登録商標です。
・※１　2013年4月現在に発売されている防水対応スマートフォンにおいて。（株式会社ネオ・マーケティング調べ）

製品トピックス④

電子化学実装関連

ポイントディップ装置
– TPシリーズ

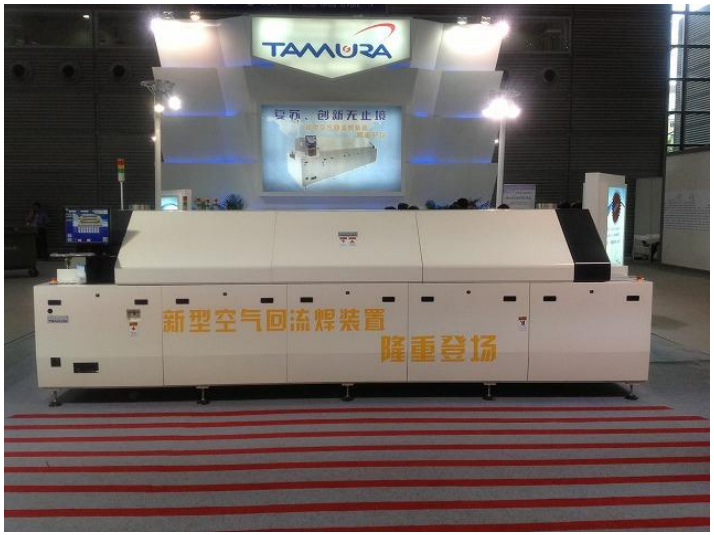
- ポイントディップシリーズとして
  - ・トレーススプレー
  - ・プリヒーター
  - ・セレクティブはんだ槽
  - ・トレースはんだ槽

  の4製品を揃えました。

- あらゆる分野にフレキシブルに対応できる
  レイアウトフリー設計で、モジュール増設時の拡張も
  可能となっています。

新型大気リフロー装置
– TAY51-508MC-F

- Nepcon South China 2013で初出展。
  多くのお客様が集まり、注目を集めました。
- 非日系市場をターゲットに、低価格を実現
- 革新的な外観デザイン
- 更なる省エネ技術を搭載



製品トピックス⑤

電子部品関連

PVリアクタ
–太陽光向け高性能標準タイプ高周波リアクタ

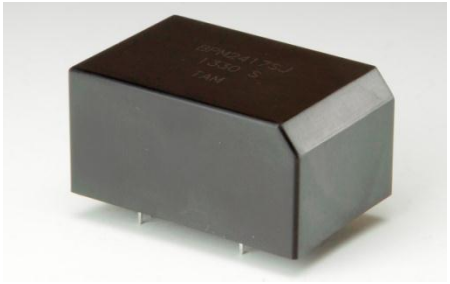
- 家庭用パワーコンディショナーに最適な標準レンジを設定した「PVリアクタ」のラインナップを拡充。
- 更に、独自開発したダストコアを使用した低騒音リアクタを追加したことで、選択の幅が広がりました。
- 形状、バリエーションと、4つのグレードからお客様の設計にあわせて組み合わせることができます。

高効率電源モジュール
ー情報機器、AV機器、産業機器、家電機器など様々な用途に

- 「高効率電源モジュール」は、低待機電力かつ高効率電源の設計を容易に実現し、設計期間短縮、開発費の削減に貢献する製品です。
- 各用途に合わせて豊富なラインナップを揃えております。

SPMシリーズ
4W以下に最適

EPMシリーズ
15W以下に最適



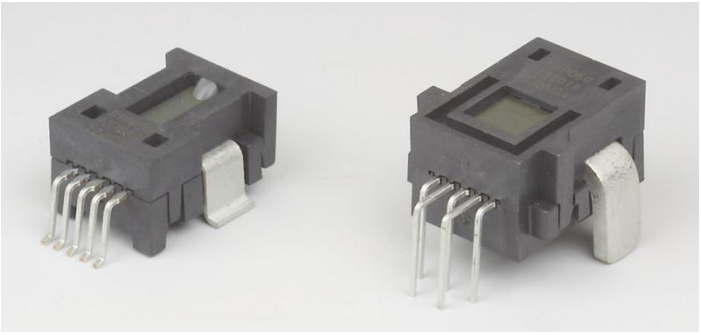
BPMシリーズ
40W以下に最適

製品トピックス⑥

電子部品関連

小型・高速応答電流センサ
– LA01シリーズ

- 専用ASICの採用により低背・小型、高速応答性を実現
- スマートメーターや民生機器の小電流計測で使われるシャント抵抗＋絶縁アンプ方式からの置き換えに最適
- 単電源：＋５V、測定電流範囲：21A～170A
- 低背(基板上8.5mm), わずか19.0mm×14.5mm のPCB搭載面積でコンパクトデザイン



情報機器関連

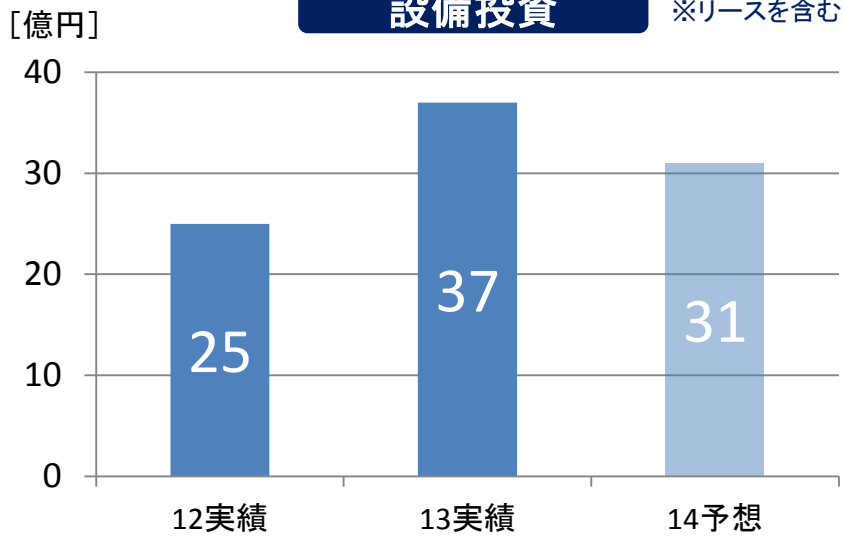
デジタル音声卓（ミキサー）
–NT660

- これまで培ってきた技術力を集結した音声卓の最上位機種「NT880」の機能と安全性を活かしながら、新たな操作方式の採用により小型化した「NT660」。
- NT660はサイズのコンパクト化により、中継車や中小規模スタジオにも最適。
- 国内外で多数の引き合いをいただいておりましたが、2013年度いよいよ出荷が始まりました。

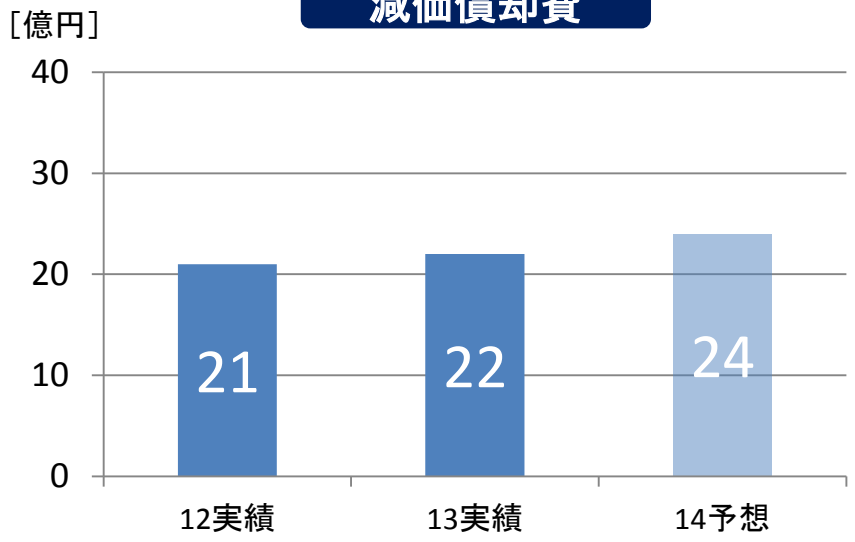
設備投資・研究開発投資

設備投資

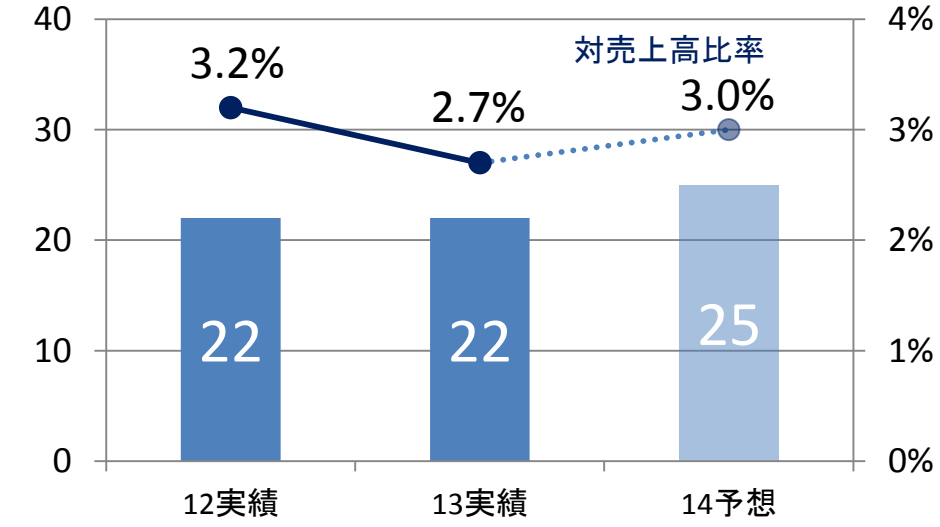
※リースを含む



減価償却費



研究開発関連費用



主な設備投資

- 電子化学: 児玉新工場生産設備増強
- 電子部品: 車載関連生産設備増強

主な開発投資

- 電子化学材料 新素材関連
- 車載用電子部品関連
- 次世代デジタルワイヤレス関連
- セミコン開発（酸化ガリウム）関連

弊社からのお願い

本資料中の業績予想、見通し及び事業計画については、
現時点における将来環境予測等の仮定に基づいております。
本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。

TAMURA
Your One and Only Company